



Japan Display Inc.

2024年度 第3四半期  
決算説明資料

2025年2月13日

株式会社 ジャパンディスプレイ



# **PersonalTech For A Better World**



Japan Display Inc.

# 2024年度第3四半期 総括

- **継続的な黒字化と持続的成長を実現する「BEYOND DISPLAY」戦略の加速化のため、茂原工場での生産を2026年3月に終了し、石川工場への生産機能集約**
- **石川工場は「G4.5 + G6」高付加価値ディスプレイ、センサー、先端半導体パッケージングの同時生産を行う「MULTI-FAB」とし、柔軟性、生産性、及びコスト競争力が極めて高く、幅広い顧客に対応可能な生産体制を構築**
- **茂原工場は、売却を主眼に、AIデータセンターのニーズのある多数の企業と交渉中**
- **茂原工場で生産中の製品は、作り溜め、石川工場への生産移管、ファウンドリーパートナーからの当社設計パネルの調達により、供給責任を遂行**

- **OLEDは生産終了に伴い自社生産を中断する一方、eLEAPのファブレス事業展開とグローバルエコシステム構築に向けてeLEAPパネルの委託生産先となるファウンドリーパートナーと協議中**
- **OLEDWorks（米国）と資本業務提携し、米国における最先端ディスプレイ工場設立に向けて協業。新工場は、防衛、自動車、医療等の重要分野向けに特化、R&Dセンターの設立も予定**

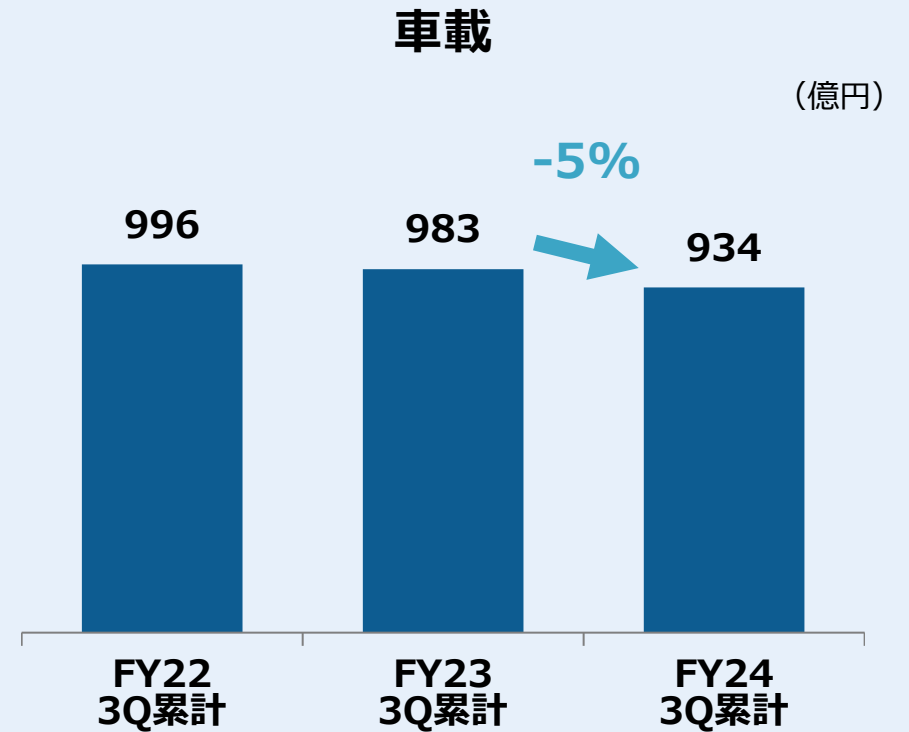
- **先端半導体パッケージング事業展開の礎として、PanelSemi（台湾）及びTECH EXTENSION（TEX、日本）と資本業務提携し、石川工場にて開発・生産**
- **世界最先端半導体パッケージング技術を有するTEXとの資本業務提携により、次世代三次元集積技術を用いた製造ラインを石川工場に構築し、当社の先端半導体パッケージング事業展開を加速化**
- **先端半導体パッケージング及びセンサー技術を手掛けるPanelSemiとの資本業務提携を通じ、高品質で低コストの次世代半導体製品を提供し、急速に拡大する半導体パッケージング市場をリード**

- 主に液晶スマートフォン及びVRの販売減により3Q累計期間の売上高は前年同期比20.5%減収
- 減収の一方、製品ミックス改善、固定費削減効率化により、3Q累計期間は前年同期比EBITDA+10%、営業利益+14%改善
- 茂原工場の減損、鳥取工場の事業構造改善費用計上により、当期純損失は悪化。これに伴い、当期純損失の通期予想を下方修正

## 長期供給契約に基づいた 安定性の高い成長ドライバー

「世界初、世界一」独自技術である  
次世代OLED eLEAP及び2VD等  
斬新な新規技術にもとづく製品の商談も活発

低採算品の販売終了や最終顧客の  
需要減により減収



※ 事業の実態を分かり易く反映するため、2023年度第2四半期決算より、売上分野の名称を次の通り変更いたしました。：「モバイル」→「液晶スマートフォン」、「ノンモバイル」→「スマートウォッチ・VR等」  
なお、当該変更は名称のみの変更であり、売上区分の変更はございません。



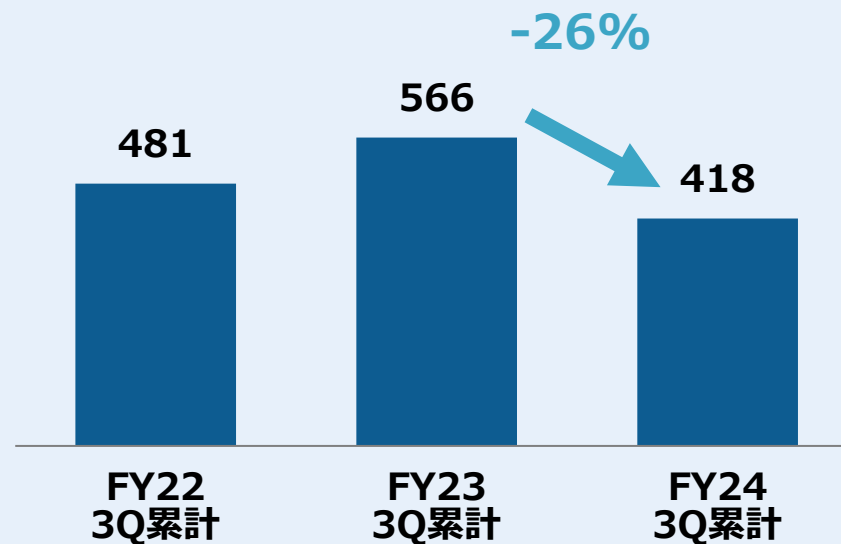
商品ポートフォリオの分散化により  
車載同様、安定性の  
高い成長ドライバーにすべく育成中

最終顧客の需要減を主要因として減収

eLEAPは今後ファブレス事業としての  
展開を推進

## スマートウォッチ・VR等

(億円)



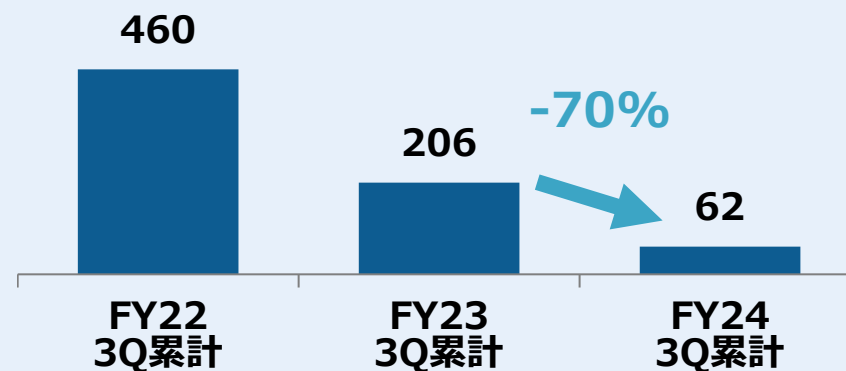
エンジニアリングリソース等、経営資源を次世代製品に集中すべく、コモディティ化されて収益性の低い液晶スマホ事業を戦略的に縮小

上記施策により 67%減収

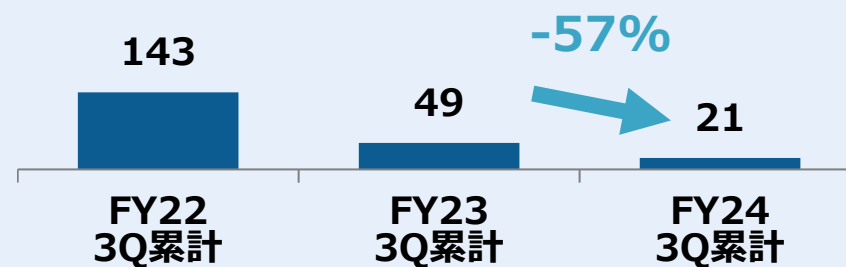
eLEAPを通じて競争優位性をもって、より収益性の高い形でスマートフォン事業に再参入

### 液晶スマートフォン/欧米

(億円)



### 液晶スマートフォン/中国





Japan Display Inc.

# 2024年度第3四半期 業績報告

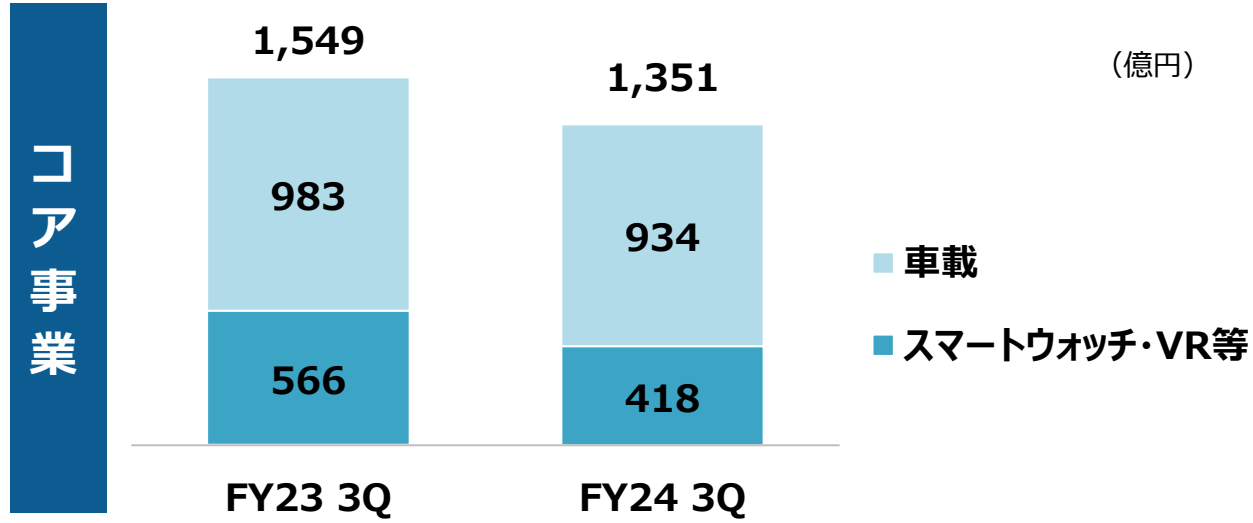
売上減となるも、EBITDA、営業利益は製品ミックス改善、固定費削減により改善。  
特別損失（減損損失、事業構造改善費用）を計上

(億円)	FY23 3Q累計	FY24 3Q累計	前年 同期比	
売上高	1,804	1,435	-21%	コア事業（車載、スマートウォッチ・VR等）は顧客需要の軟化により減収。ノンコア事業（液晶スマートフォン）は経営資源の成長事業への集中による戦略的縮小から減収
コア事業	1,549	1,351	-13%	
ノンコア事業	255	83	-67%	
EBITDA	△230	△207	+23	売上減も、製品ミックス改善、固定費削減により 損失を縮小
営業利益	△277	△237	+39	
当期純利益	△380	△488	-108	減損損失 209億円（前年同期は110億円を計上） 事業構造改善費用 24億円計上（鳥取工場生産終了） 固定資産売却益 18億円計上（主に旧東浦工場売却）

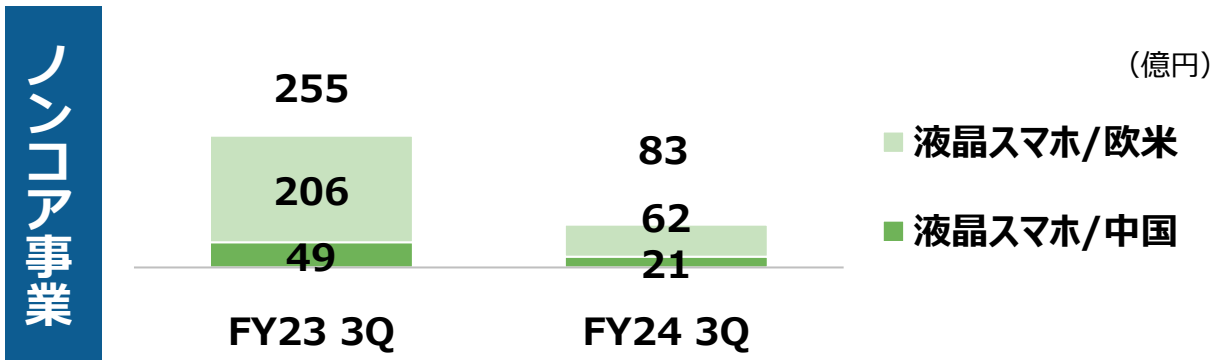
## 製品ミックス改善、固定費削減により利益改善を図るも、売上減少の影響大きく損失拡大 特別損失（減損損失、事業構造改善費用）を計上

(億円)	FY23 3Q会計	FY24 3Q会計	前年 同期比	
<b>売上高</b>	<b>605</b>	<b>405</b>	<b>-33%</b>	コア事業（車載、スマートウォッチ・VR等）は顧客需要の軟化により減収。ノンコア事業（液晶スマートフォン）は経営資源の成長事業への集中による戦略的縮小から減収
<b>コア事業</b>	<b>517</b>	<b>400</b>	<b>-23%</b>	
<b>ノンコア事業</b>	<b>88</b>	<b>5</b>	<b>-94%</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>△49</b>	<b>△73</b>	<b>-24</b>	製品ミックス改善及び固定費削減効果はあったものの、売上減の影響が大きく減益
<b>営業利益</b>	<b>△62</b>	<b>△83</b>	<b>-20</b>	
<b>当期純利益</b>	<b>△93</b>	<b>△319</b>	<b>-227</b>	減損損失 204億円（前年同期は18億円を計上） 事業構造改善費用 24億円計上（鳥取工場生産終了）

## コア事業（車載、スマートウォッチ・VR等）は顧客需要の軟化により減収 ノンコア事業（液晶スマートフォン）は戦略的縮小により減収

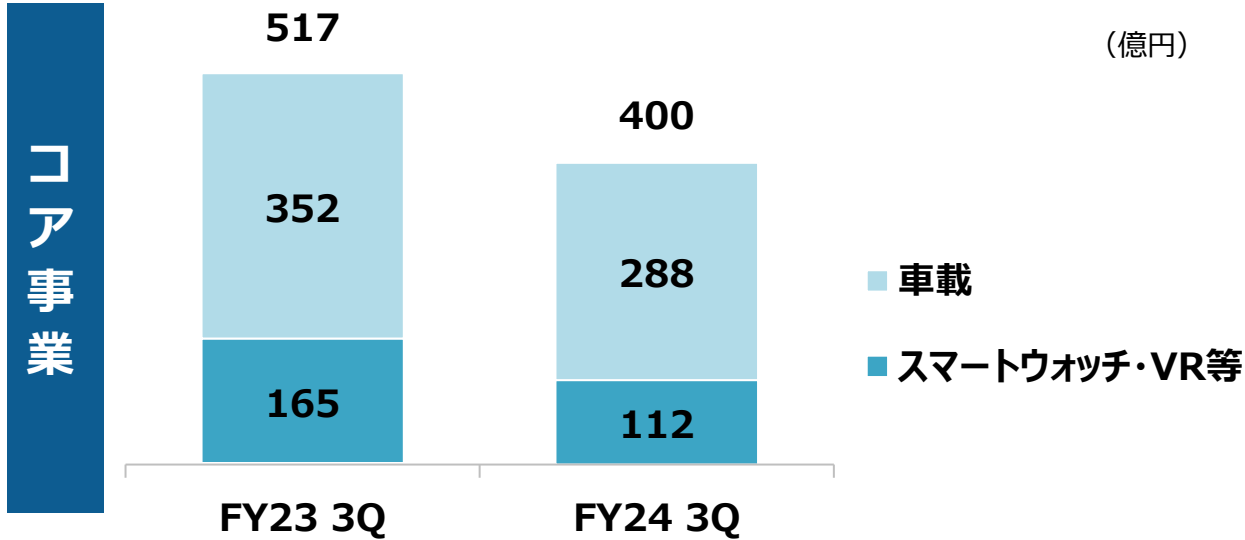


- **車載 (YoY -5.0%)**  
 新製品の販売増の一方、低採算品の販売終了及び中国EVメーカーのシェアの拡大に起因する需要減により減収
- **スマートウォッチ・VR等 (YoY -26.2%)**  
 VR、スマートウォッチともに顧客需要減少により減収

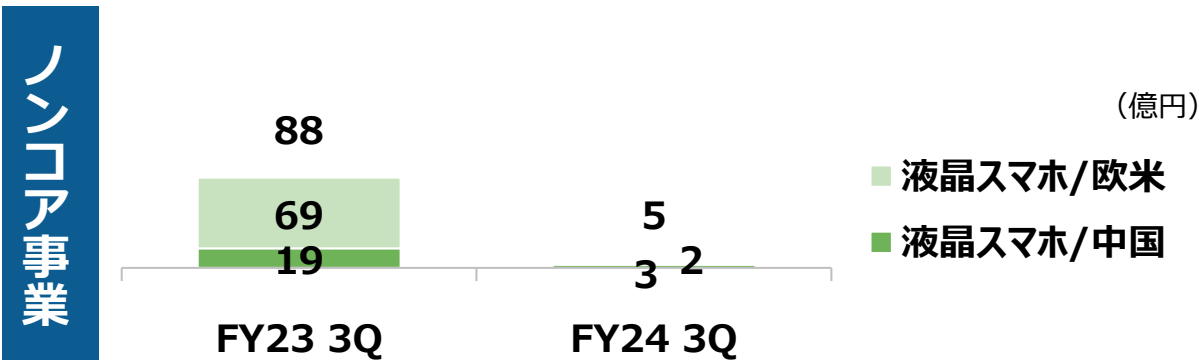


- **液晶スマートフォン (YoY -67.3%)**  
 エンジニアリングリソース等の経営資源を次世代製品に集中するための戦略的縮小により減収

## 主にOLEDスマートウォッチの需要減によりコア事業（車載、スマートウォッチ・VR等）減収 戦略的縮小によりノンコア事業（液晶スマートフォン）減収



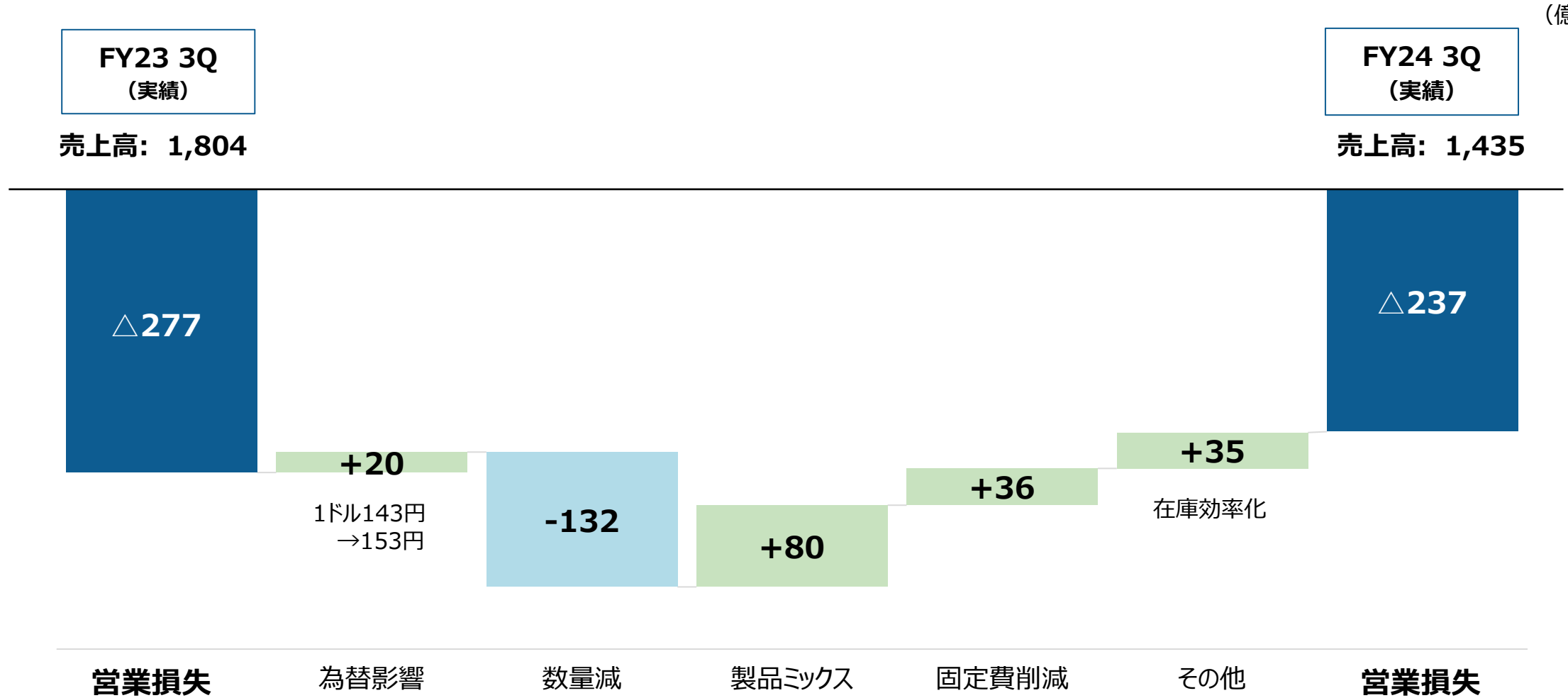
- **車載 (YoY -18.2%)**  
新製品の販売増の一方、低採算品の販売終了及び中国EVメーカーのシェアの拡大に起因する需要減により減収
- **スマートウォッチ・VR等 (YoY -31.8%)**  
主にOLEDスマートウォッチの需要減により減収



- **液晶スマートフォン (YoY -94.0%)**  
エンジニアリングリソース等の経営資源を次世代製品に集中するための戦略的縮小により減収

## 前年同期比

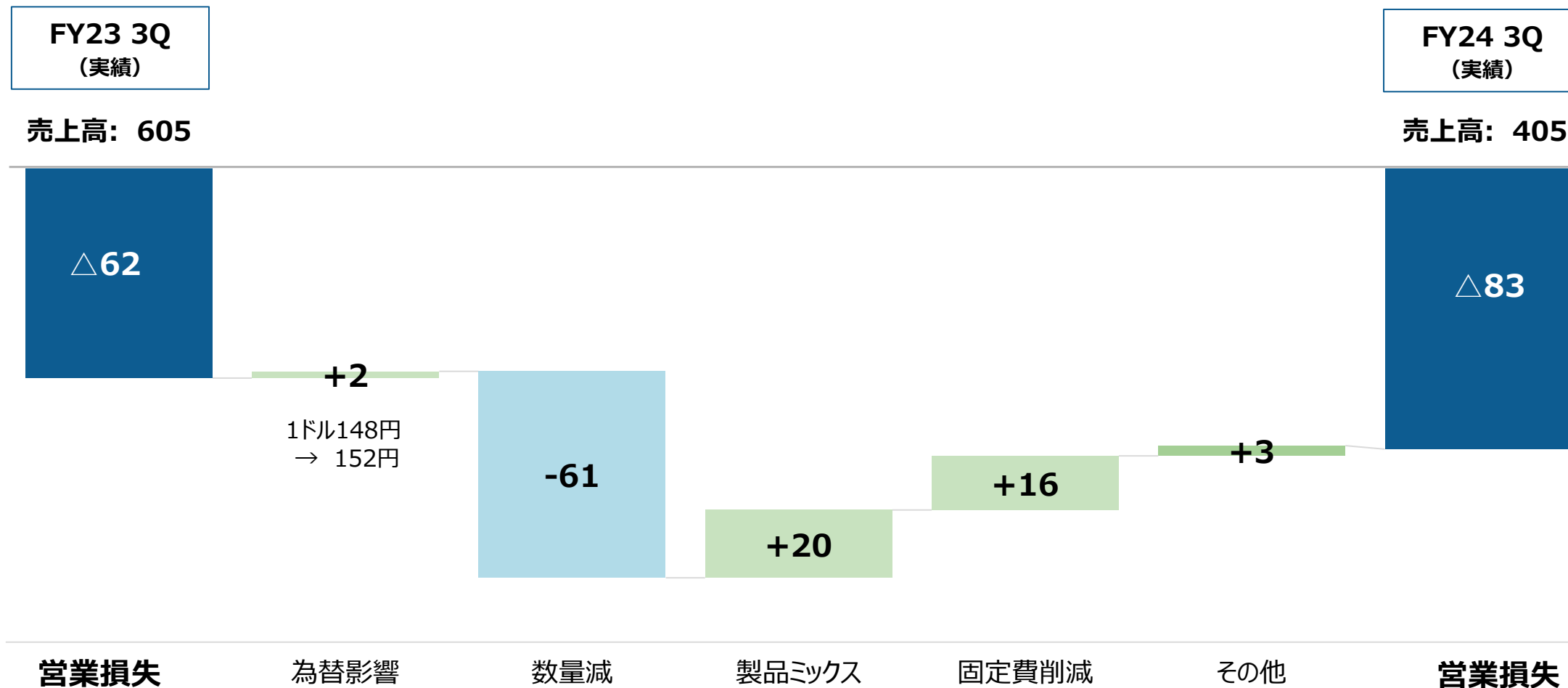
(億円)



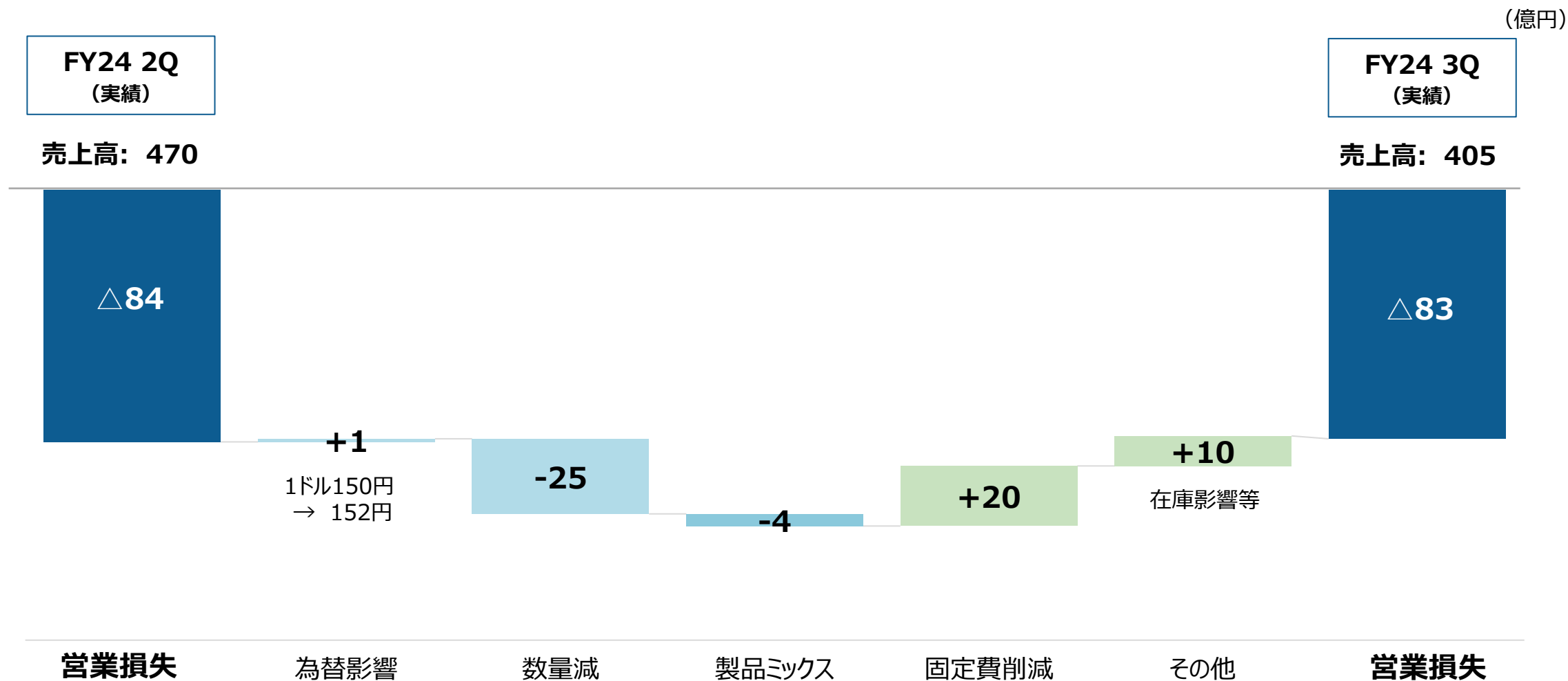


## 前年同期比

(億円)



## 前四半期比





Japan Display Inc.

# 2024年度 業績予想

## 3Qにおける工場関連の特別損失の計上を反映し、当期純利益の通期予想を下方修正

(億円)	FY24	FY24	差異
	通期 前回予想	通期 今回予想	
<b>売上高</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>
車載（コア事業）	1,197	1,197	0
スマートウォッチ・VR等（コア事業）	517	517	0
液晶スマートフォン/欧米（ノンコア事業）	62	62	0
液晶スマートフォン/中国（ノンコア事業）	24	24	0
<b>EBITDA</b>	<b>△ 264</b>	<b>△ 264</b>	<b>0</b>
<b>営業利益</b>	<b>△ 317</b>	<b>△ 317</b>	<b>0</b>
<b>経常利益</b>	<b>△ 368</b>	<b>△ 368</b>	<b>0</b>
<b>当期純利益</b>	<b>△ 393</b>	<b>△ 621</b>	<b>-228</b>

※FY24 4Q想定為替レート：1ドル=150円



Japan Display Inc.

# 「BEYOND DISPLAY」 新生JDIの事業戦略

# JDI

# BEYOND DISPLAY

# JDI コア・ケイパビリティ

世界屈指の  
技術力

長年に亘り蓄積された  
日立、ソニー、東芝の  
ディスプレイ技術及び  
エンジニアリングリソースが  
集結され、  
「世界初、世界一」の  
独自技術を創出し続ける  
世界の  
ディスプレイトップメーカー

豊富な  
知的財産

16,000件以上の保有・  
出願特許権等からなる  
強固な知的財産権  
ポートフォリオを強みに、  
クロスライセンス契約で  
ライセンス料受領の  
立ち位置を誇る

盤石な  
顧客基盤

業界トップクラスの品質と  
長年に渡る丁寧な顧客  
対応が礎となっている  
圧倒的な顧客からの信頼  
と強固なJDIブランド  
ロイヤリティ

地政学的  
優位性

地政学的緊張感が  
高まるなか、  
「MADE IN JAPAN」が  
提供するグローバル・  
ディスプレイ・  
サプライチェーンにおける  
多様化とリスク低減効果  
は顧客ニーズと合致

## 半導体・センサー・マイクロディスプレイの生産における経済性は 汎用ディスプレイを凌駕

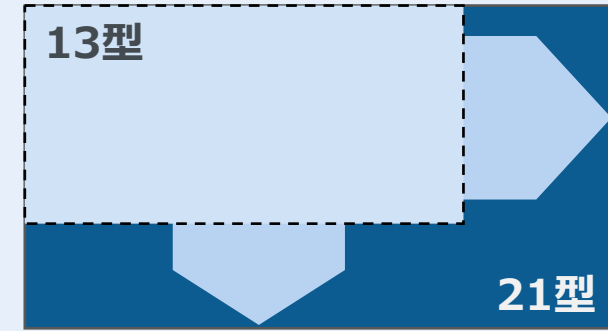
### 半導体・センサー・マイクロディスプレイ サイズ縮小の原則



#### より **小さな製品**を顧客は指向

- 製品サイズの縮小は基板あたりより多くの製品数確保を可能とする
- 販売単価は製品サイズの縮小と相関しない
- 事業の経済性が増加傾向にある

### 汎用ディスプレイ サイズ拡大の原則



#### より **大きな製品**を顧客は指向

- 製品サイズの拡大は基板あたりの製品数の減少を意味し、需要に追従していくためには多額の設備投資を要する
- 販売単価は製品サイズの拡大に完全に連動しない
- 事業の経済性が減少傾向にある



多様な製品の同時生産を可能とし、柔軟性、生産性、及びコスト競争力の極めて高い、幅広い顧客に対応できる生産体制を構築

石川工場の既存  
G4.5製造設備  
&  
茂原工場のG6セル設備  
の移設

## 石川工場 MULTI-FAB化

- ✓ 製品柔軟性
- ✓ 最先端技術
- ✓ 優れたコスト競争力

ディスプレイ、先端半導体  
パッケージング、センサーの  
幅広い製品に対応

- G4.5 + G6高付加価値ディスプレイに対応可
- 固定費が茂原工場の約4分の1
- 極めて高い柔軟性、生産性、コスト競争力

- 半導体・センサー・マイクロディスプレイにより適しているG4.5基板サイズ
- 「BEYOND DISPLAY」戦略における製品拡充に最も適した生産体制の構築が可能

アセットライト化と生産効率の抜本的向上の観点から固定費負担の大きい茂原工場でのパネル生産を終了し、資産売却を通じ財務基盤の大幅改善を図る

## G6ディスプレイ工場 としての茂原工場

## AIデータセンター としての茂原工場



極めて高い技術力を有するも



低稼働による低採算性が継続

- 茂原工場のJ1建屋はAIデータセンターが必要とする仕様により適している要素を多くもつ
- 茂原工場全体で**100MW強**の電力供給が可
- 資産売却による収入で財務基盤が大きく改善

**FY24 2Q決算発表時に案内した茂原工場V3エリアに加え、J1エリアを含めた茂原工場全体のAIデータセンター化はより多くの貴重な資源の提供を通じた付加価値に繋がる**

## J1エリアの特徴（今回追加）

- 建屋の天井高が最大で 8m
- 建屋の床耐荷重能力が最大で 2トン/m<sup>2</sup>
- 1日当たりの工業用水量が 8,000m<sup>3</sup>
- ファシリティ・エンジニアなど多くの優れた人員

## 前回公表: V3エリア



- 生成AIをはじめとした計算処理の爆発的成長に伴い、AIデータセンターにおける莫大な計算量が必要
- 必要計算量の爆発的成長と連動して国内におけるAIデータセンター需要が増大中

生成AI

クラウド  
運営業者

通信業者

コンテンツ  
製作者

これらエンドユーザーのすべてが  
国内でのデータセンター計算量を必要

IT企業

SI企業

金融機関

国内計算量需要  
2020年~2040年  
10万倍

国内データセンター  
需要が爆発的に拡大

VS

データセンター拡張における  
3大阻害要因

適地不足:国土の73%  
ほどが山岳地帯、  
津波リスク、  
良地は活用済み

データセンターに  
必要不可欠な  
高圧電力への  
接続が困難

建設市場の  
需給逼迫による  
5年超の長い  
リードタイム

阻害要因 ①  
適地

阻害要因 ②  
電力

阻害要因 ③  
建設

JDIの茂原工場が提供できる多くの資源・強みを活かすことで、AIデータセンター事業者はデータセンター立上げまでの時間を大幅短縮することが可能



## 適地 (J1+V3合計)

土地面積:

**338,983 m<sup>2</sup>**

大手町中心部まで **57 km**

沿岸から **8 km**



## 電力・インフラ (J1+V3合計)

電力供給能力:

**>100 MW**

工業用水供給能力:

一日当たり **18,000 m<sup>3</sup>**



## 建設 (J1+V3合計)

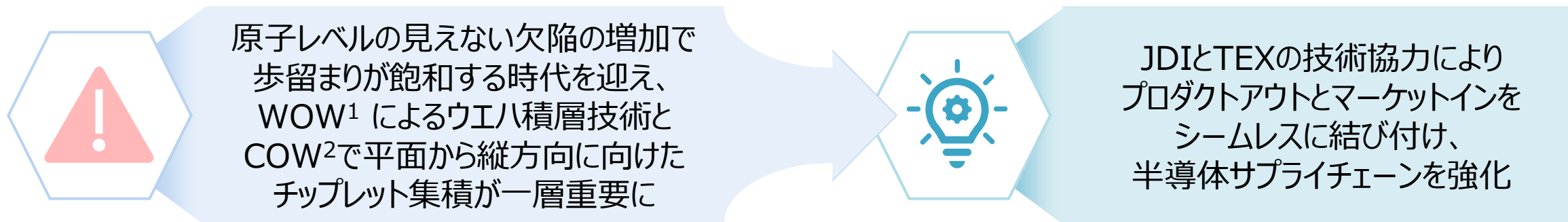
延べ床面積:

**368,960 m<sup>2</sup>**

クリーンルーム面積:

**178,021 m<sup>2</sup>**

## JDIとTEXは、石川 MULTI-FAB工場にて 製造から販売までのシームレスなサプライチェーンを構築



## JDIの石川 MULTI-FABと、TEXの世界最先端技術により、 両社はポスト微細化時代の次世代三次元集積技術の展開を加速

**1 WOW (Wafer on Wafer)** : ウエハ上に約10ミクロン厚さのウエハを接合しながら接続配線し、何枚も積み上げることができる積層技術。DRAMなど同一チップサイズのウエハ積層の生産性向上に大きく寄与する

**2 COW (Chip on Wafer)** : チップレットをウエハ上に接合しながらWOW技術で接続配線する技術。チップをトレンチ加工したウエハ（ワッフルウエハ）上に接合することにより、以降の半導体製造工程において、各種ウエハプロセス装置を用いた高精度な配線加工が行えるようになる。異なるチップサイズの接合も行えることから、サーバーなどの大規模演算2.5Dシステムだけでなく、搭載される異種機能デバイスシステムを超小型化で三次元集積することが可能になる

## TEXの世界最先端三次元集積技術を使った製造ラインを JDIの石川 MULTI-FAB工場に構築

### テック・エクステンション (TEX)

Science Tokyo (東京科学大学) のWOW Allianceから創  
生され、世界最先端の半導体パッケージング技術を有する

ディープテックであるBBCube<sup>1</sup> 技術を開発

BBCube技術のプラットフォームであるWOW 技術と  
COW 技術における深い知見

### JDIによる TEX への投資

### 技術移転、共同 R&D 及び 実施ガイダンス

### JDI 石川 MULTI-FAB

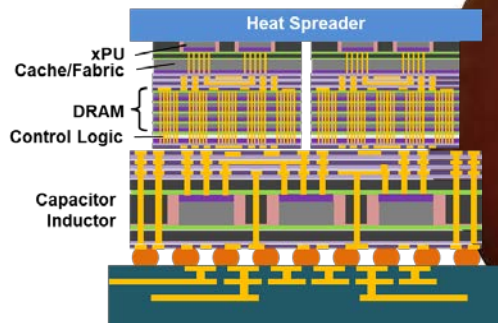
JDIの高度な高密度配線技術、薄膜・ガラス加工の専門知識を  
有し、先進的な半導体パッケージングのために必要な設備を備える

WOWからPLP (パネルレベルパッケージング) までの  
BBCube技術に基づく次世代三次元集積を  
新たな製造ラインで生産。半導体パッケージング用の  
ガラス基板も共同開発

**1 BBCube (Bumpless Build Cube)** : 従来の平置きチップレットを三次元でコンパクトにまとめ、 bumps を利用しないでシステムの小型化を可能にするアーキテクチャーで従来のシステムに比べ1/1000となる低消費電力が可能



## BBCube Era

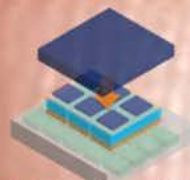


BBCube 3D

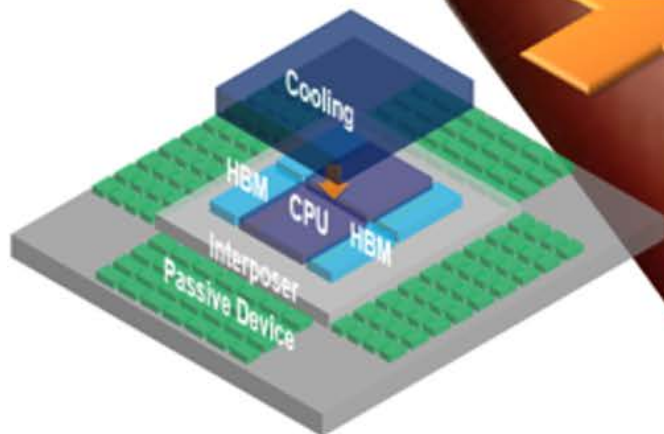


指先にのるほど小さなテラバイトBBCube

高エネルギー効率でコストを最小化するためには  
“微細化”と“ウエハスケールの3Dプロセス”が必要となる



BBCube 3D



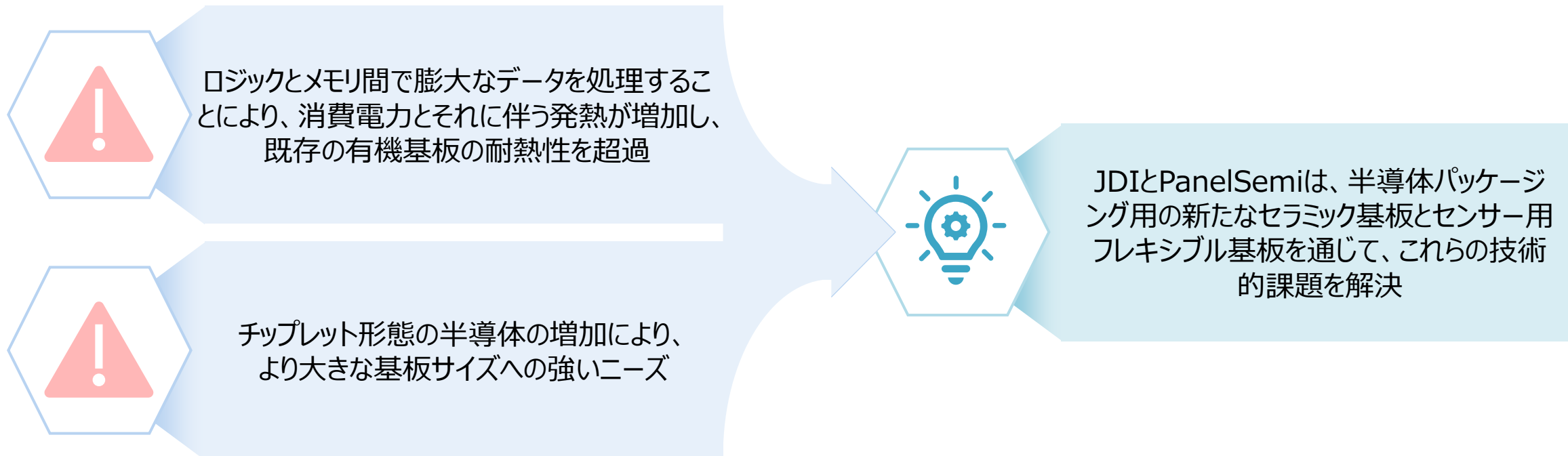
従来の 2.5D

BBCube = Bumpless Build Cube  
設計・製造プロセスの共同最適化  
300mmウエハプロセス  
WOW技術・COW技術の融合  
並列高密度バンプレス相互接続  
超薄型 <10 $\mu$ m



**BBCube:** 従来は平面上に配置されていたチップレットを、バンプを使用せずにコンパクトな3D構造とすることにより、システムの小型化 & 従来比1/1000の低消費電力を実現

## JDIとPanelSemiの提携により、先端半導体パッケージング用基板、 及びセンサー用基板の事業化を加速



**JDIとPanelSemiは、高品質で低コストの次世代半導体製品を提供し、  
急速に拡大する半導体パッケージング市場をリード**

## JDIとPanelSemiは、両社の専門知識とエンジニアリングリソースを活用し、 早期の事業化を推進

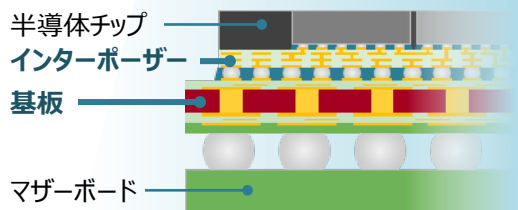
### PanelSemiの強み

- 深いTFTパネルの専門知識とサプライチェーンの関係を  
持つトップエンジニア
- 日本ガイシ株式会社との戦略関係を通じてアクセス可  
能な最先端のセラミック材料技術を活用
- セラミック基板のサイズと精度の限界を克服するための世  
界クラスのタイリング技術

### JDIによる PanelSemi への投資

### JDIの強み

- ディ스플레이事業で培われた高密度配線技術と薄膜/ガ  
ラス加工技術
- 試作から量産までの最高水準の生産技術
- 半導体関連技術の柔軟な生産と開発のための石川  
MULTI-FAB



### 共同開発と事業化:

- ディ스플레이由来の技術に基づく半導体パッケージング用セラミック基板
- ガラスをキャリアとして使用する有機インターポザー
- 先端センサー技術の開発・生産

## 先進的な半導体パッケージングのための複合的な提携により、 JDIは半導体市場に独自の価値を提供

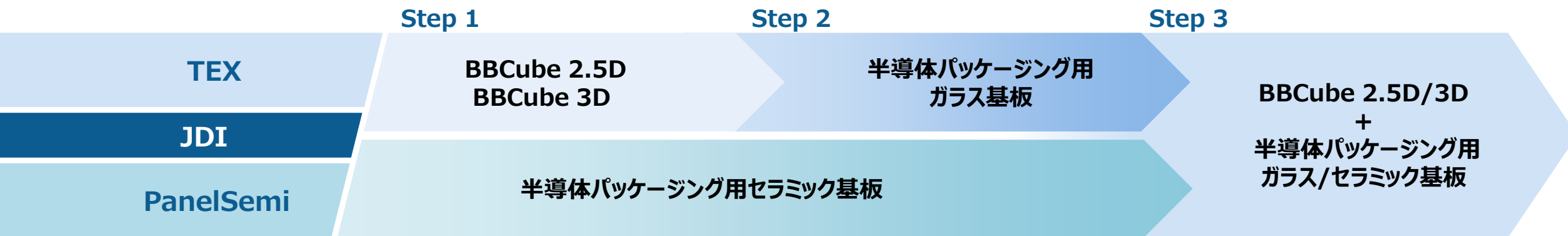
JDIと共同で:



**テック・エクステンション (TEX)**  
BBCube技術によるシステム性能の向上、  
消費電力の削減、及び熱の低減



**PanelSemi**  
半導体インターポーザーに使用されるセラミック材料の  
最先端加工技術



JDIは、先端半導体パッケージングにおいて、大型ガラス基板のための世界クラスの超高精度加工技術を活用  
サーバーやPCの性能向上に伴い、成長市場である先端半導体パッケージング事業の拡大を推進


## JDIはOLEDWorksと提携し、最先端ディスプレイ工場を米国に立ち上げ

### OLEDWorks

- マルチスタックOLED技術の世界的リーダー
- 米国におけるプレゼンスとケイパビリティ、マルチスタックOLED技術、製造及び製品の強み
- アジア以外で唯一の主要なOLEDメーカー

### JDI

- 先端ディスプレイ及びOLEDにおける世界クラスのノウハウ、技術、製造、および製品化力
- 自動車、産業、医療分野でのディスプレイプロジェクト及びアプリケーションの豊富な経験
- 世界中に確立されたビジネスリレーションシップと、北米における強力なプレゼンス



米国で新たに設立されるファブは、防衛、自動車、医療用途を含む重要な産業向けに高性能ディスプレイを提供することに注力し、米国の産業競争力と国家安全保障に貢献

## OLEDWorksとJDIのディスプレイ生産計画の主要ポイント

- 先端ディスプレイとOLEDの世界クラスのノウハウ、技術、製造、製品化力を活用
- 米国の防衛、自動車、医療産業の主要なステークホルダーのニーズを満たす斬新で拡張性が高い工場の設立
- 事業の長期的な持続可能性を確保する顧客パートナーシップの構築
- ディ스플레이産業を支えるキーパーツ、部品、材料及び装置に関わる米国サプライヤーとのパートナーシップ
- 最先端のディスプレイR&Dセンターの設立、及び顧客、サプライヤー、テクノロジーパートナーとの協業による米国内のイノベーション育成とエコシステム構築
- ディ스플레이生産拡大に向けた人材育成、大学との協力関係強化
- 顧客の目先のニーズ及び中長期技術ロードマップを満たす高性能LCD及びOLEDディスプレイの生産体制の確立

現在  
茂原J1工場  
のeLEAP  
生産ライン

## 今後 ファウンドリーパートナーとのeLEAPファブレス生産

### ファブレスとファウンドリーモデルの確立

- ✓ eLEAPの生産能力を早期に拡大
- ✓ eLEAPの市場投入までの時間を短縮
- ✓ パートナーの競争力あるコスト基盤を活用
- ✓ JDIの設備投資を削減

JDIは、eLEAPの生産拡大に向けて  
ファウンドリーパートナーと協議中

JDIは、ディスプレイ生産を石川工場及びファウンドリーパートナーに移管し、  
供給責任を全う

## 石川 MULTI-FAB

石川MULTI-FABの **Gen 6 セル**生産設備  
(茂原工場J1から石川工場へ)

石川MULTI-FABの **Gen 4.5** 生産設備

## ファウンドリーパートナー

eLEAPをはじめとするJDIの「世界初、世界一」技術をファブレス化し、  
ファウンドリーパートナーとの協力を通じてJDIとしてお客様に供給

今後のJDI  
ディスプレイ  
生産体制



## BEYOND DISPLAY戦略の推進とJDIの持続的収益につながる取り組み

# JDI BEYOND DISPLAY

生産終了  
&  
茂原J1工場のデータ  
センターへの転換

OLEDWorks との  
米国における最先端  
ディスプレイ工場  
立ち上げに向けた  
戦略提携

センサー、半導体、  
G4.5 + G6ディスプレイ  
生産に対応する  
石川MULTI-FAB

PanelSemi との  
先端半導体  
パッケージング生産に  
向けた戦略提携

eLEAP生産の  
ファブレス化と  
生産能力の拡充

TEX との  
次世代半導体  
技術生産に向けた  
戦略提携

センサー開発、技術  
革新や戦略提携



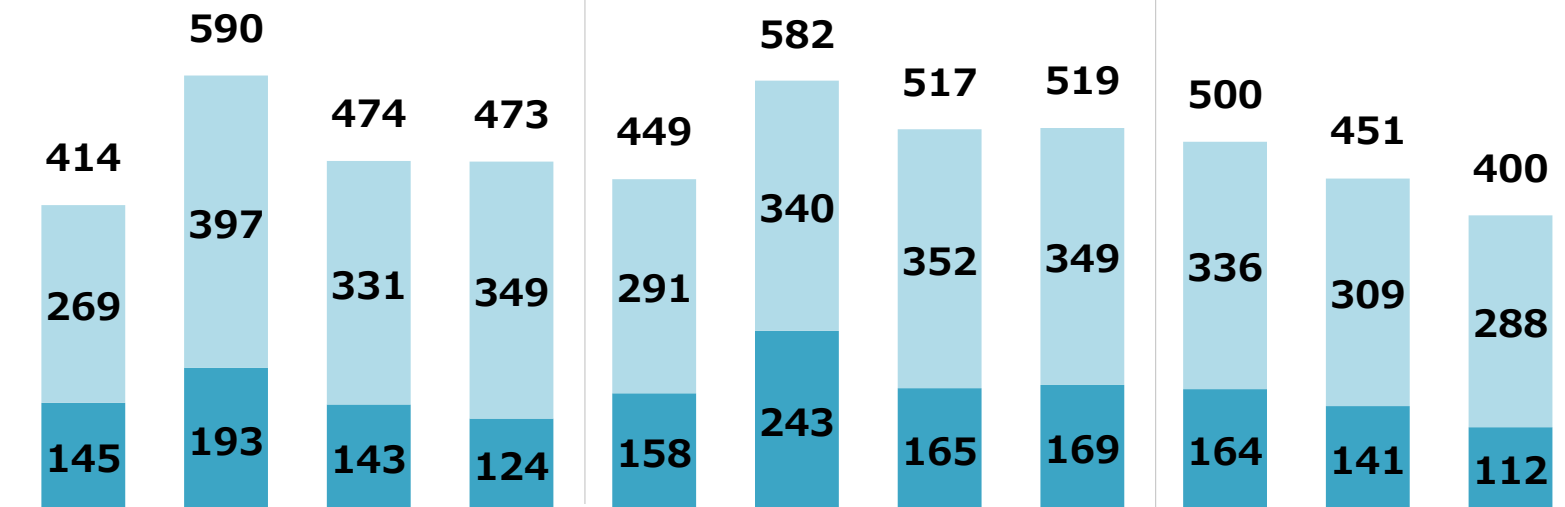
Japan Display Inc.

# Appendix

# 分野別四半期売上高推移

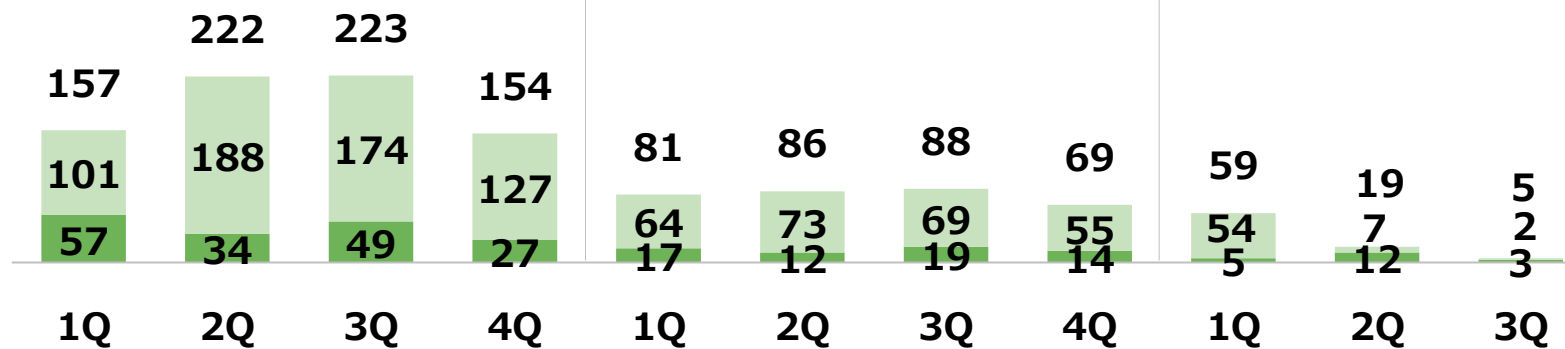
(億円)

## コア事業



- 車載
- スマートウォッチ・VR等

## ノンコア事業



- 液晶スマートフォン/欧米
- 液晶スマートフォン/中国

FY22

FY23

FY24

(億円)	FY23 期末	FY24 3Q末	前年度末比
現金及び預金	293	244	-49
売掛金	293	214	-79
未収入金	179	96	-84
在庫	640	658	+19
その他流動資産	115	54	-61
<b>流動資産合計</b>	<b>1,520</b>	<b>1,266</b>	-253
<b>固定資産合計</b>	<b>720</b>	<b>498</b>	-222
<b>資産合計</b>	<b>2,240</b>	<b>1,765</b>	-475
買掛金	463	365	-98
有利子負債	348	535	+188
未払金	181	115	-66
その他負債	392	379	-13
<b>負債合計</b>	<b>1,383</b>	<b>1,393</b>	+10
<b>純資産合計</b>	<b>857</b>	<b>371</b>	-485
<b>自己資本比率</b>	<b>38.1%</b>	<b>20.9%</b>	-17.2ポイント

(注) 貸借対照表の「現金及び預金」の額と、キャッシュフロー計算書「期末現預金残高」の額との差異は、「預け金」です。

(億円)	FY23 3Q (9か月)	FY24 3Q (9か月)	YoY	FY23 3Q (3か月)	FY24 3Q (3か月)	YoY
<b>売上高</b>	<b>1,804</b>	<b>1,435</b>	-369	<b>605</b>	<b>405</b>	-199
<b>EBITDA</b>	△ <b>230</b>	△ <b>207</b>	+23	△ <b>49</b>	△ <b>73</b>	-24
<b>営業利益</b>	△ <b>277</b>	△ <b>237</b>	+39	△ <b>62</b>	△ <b>83</b>	-20
営業外収益	51	22	-29	14	12	-2
営業外費用	△ 39	△ 46	-6	△ 25	△ 17	+8
<b>経常利益</b>	△ <b>264</b>	△ <b>260</b>	+4	△ <b>73</b>	△ <b>87</b>	-14
特別利益	1	18	+17	0	0	+0
特別損失	△ 110	△ 235	-125	△ 18	△ 228	-210
税引前四半期純利益	△ 374	△ 477	-104	△ 91	△ 315	-223
<b>四半期純利益</b>	△ <b>380</b>	△ <b>488</b>	-108	△ <b>93</b>	△ <b>319</b>	-227
平均為替レート (円/米ドル)	143.3	152.6		147.9	152.4	
期末為替レート (円/米ドル)	141.8	158.2		141.8	158.2	

(億円)	FY23 3Q (9か月)	FY24 3Q (9か月)	YoY
税引前四半期純利益	△ 374	△ 477	-104
減価償却費	47	31	-17
減損損失	110	209	+99
運転資金の増減額	138	50	-88
その他	△ 34	△ 5	+29
<b>営業キャッシュ・フロー</b>	<b>△ 112</b>	<b>△ 193</b>	<b>-81</b>
固定資産の取得による支出	△ 103	△ 67	+36
固定資産の売却による収入	2	59	+57
その他	△ 13	△ 37	-24
<b>投資キャッシュ・フロー</b>	<b>△ 114</b>	<b>△ 44</b>	<b>+70</b>
短期借入金の純増減額	240	185	-55
その他	△ 5	△ 2	+3
<b>財務キャッシュ・フロー</b>	<b>235</b>	<b>183</b>	<b>-52</b>
期末現預金残高	275	238	-38
<b>フリー・キャッシュ・フロー</b>	<b>△ 215</b>	<b>△ 260</b>	<b>-45</b>

(注) 「フリー・キャッシュ・フロー」は、「営業キャッシュ・フロー」と「固定資産の取得による支出」の合計額です。



# THANK YOU

## 将来予測及び見通しに関して

本資料に記載される業界、市場動向または経済情勢等に関する情報は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成しているものであり、当社がその真実性、正確性、合理性および網羅性について保証するものではありません。

また、本資料に記載される当社グループの計画、見積もり、予測、予想その他の将来情報については、現時点における当社の判断又は考えにすぎず、実際の当社グループの経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の個人消費その他の経済情勢、為替動向、ディスプレイを搭載するの電子機器の市場動向、主要取引先の経営方針、原材料価格の変動等により、本資料記載の内容またはそこから推測される内容と大きく異なることがあります。